

名稱】：TQFP/LQFP64~32 & QFN64 轉 DIP

【型號】：MP6464QS2

【品牌】：SmartCool

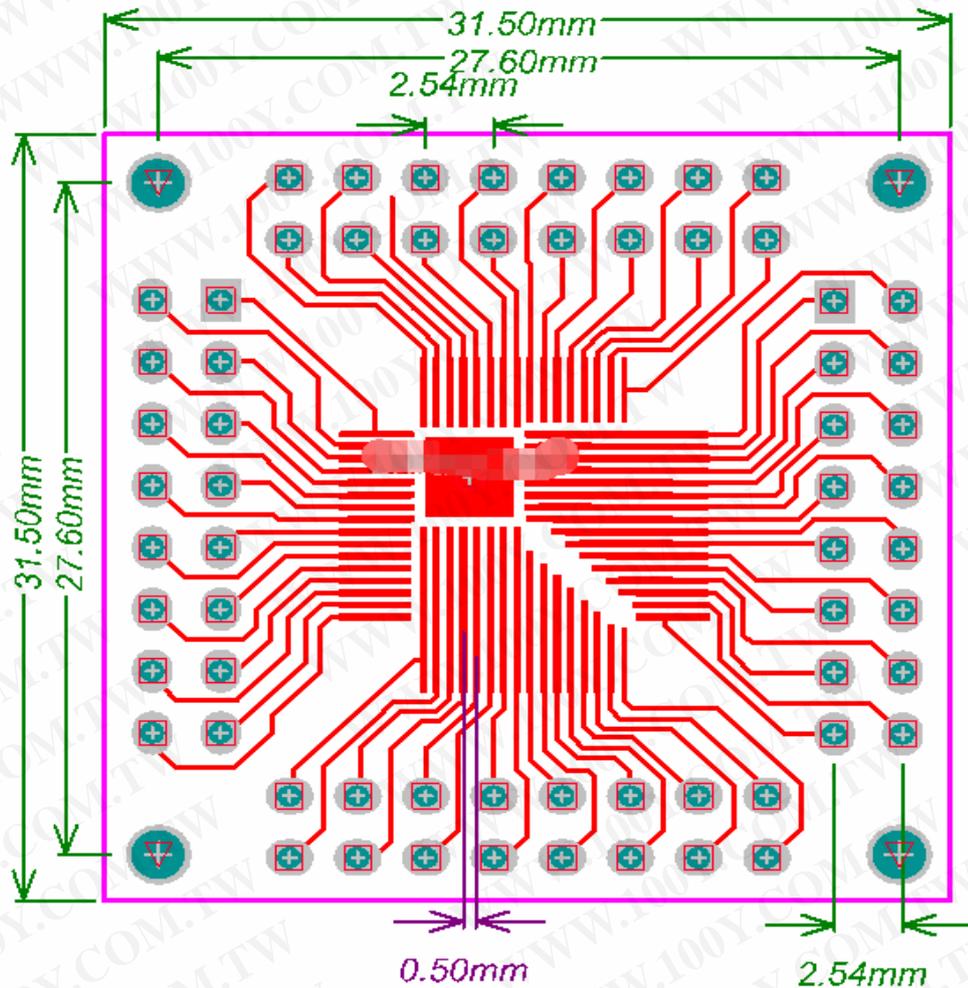
【描述】：

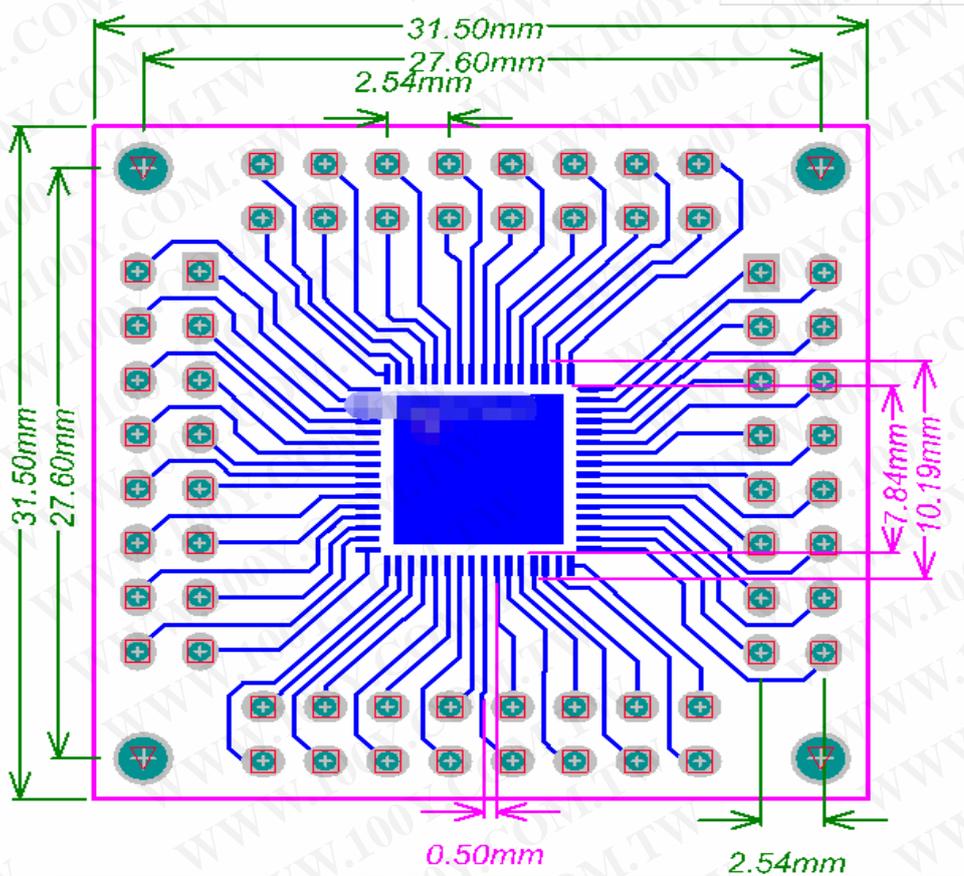
板材：FR4 板材，板色：黑色，板層：2 層，板厚：1.6mm，銅厚：1OZ，焊盤：採用化學沉金工藝（即焊盤表面特殊鍍金）

尺寸：31.5\*31.5\*1.6mm

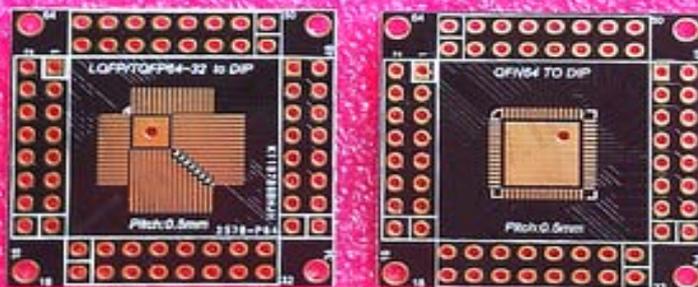
用途：本轉接板適用於以下晶片封裝【①、Pitch（腳與腳間距）=0.5mm 的 LQFP/TQFP32、LQFP/TQFP36、LQFP/TQFP40、LQFP/TQFP44、LQFP/TQFP48、LQFP/TQFP52、LQFP/TQFP54、LQFP/TQFP60、LQFP/TQFP64、；②、Pitch（腳與腳間距）=0.5mm 的 SSOP32、TSSOP32、QFN64、QFN32；③、Pitch（腳與腳間距）=0.5mm 的 QFN32；】

特點：可支援多個貼片封裝晶片轉外掛程式（但每個板一次只能焊接一個晶片轉外掛程式）





TQFP64-32 & QFN64 转 DIP  
Pitch=0.5mm ( e=0.5mm )



正面：TQFP/LQFP64-32转DIP(e=0.5mm)

反面：QFN64转DIP 焊盘沉金 (e=0.5mm)